

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 6 月 9 日 (09.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/052517 A1

(51) 国際特許分類⁷: G01D 5/12, B29C 45/14, H05K 5/00

[JP/JP]; 〒4488650 愛知県刈谷市朝日町 2 丁目 1 番地
Aichi (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/017654

(22) 国際出願日: 2004 年 11 月 19 日 (19.11.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2003-398756
2003 年 11 月 28 日 (28.11.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): アイシン
精機株式会社 (AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA)

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 奥谷 久義
(OKUYA, Hisayoshi) [JP/JP]; 〒4488650 愛知県刈谷市
朝日町 2 丁目 1 番地 アイシン精機株式会社内 Aichi
(JP). 保田 敬司 (YASUDA, Keiji) [JP/JP]; 〒4488650 愛
知県刈谷市朝日町 2 丁目 1 番地 アイシン精機株式
会社内 Aichi (JP).

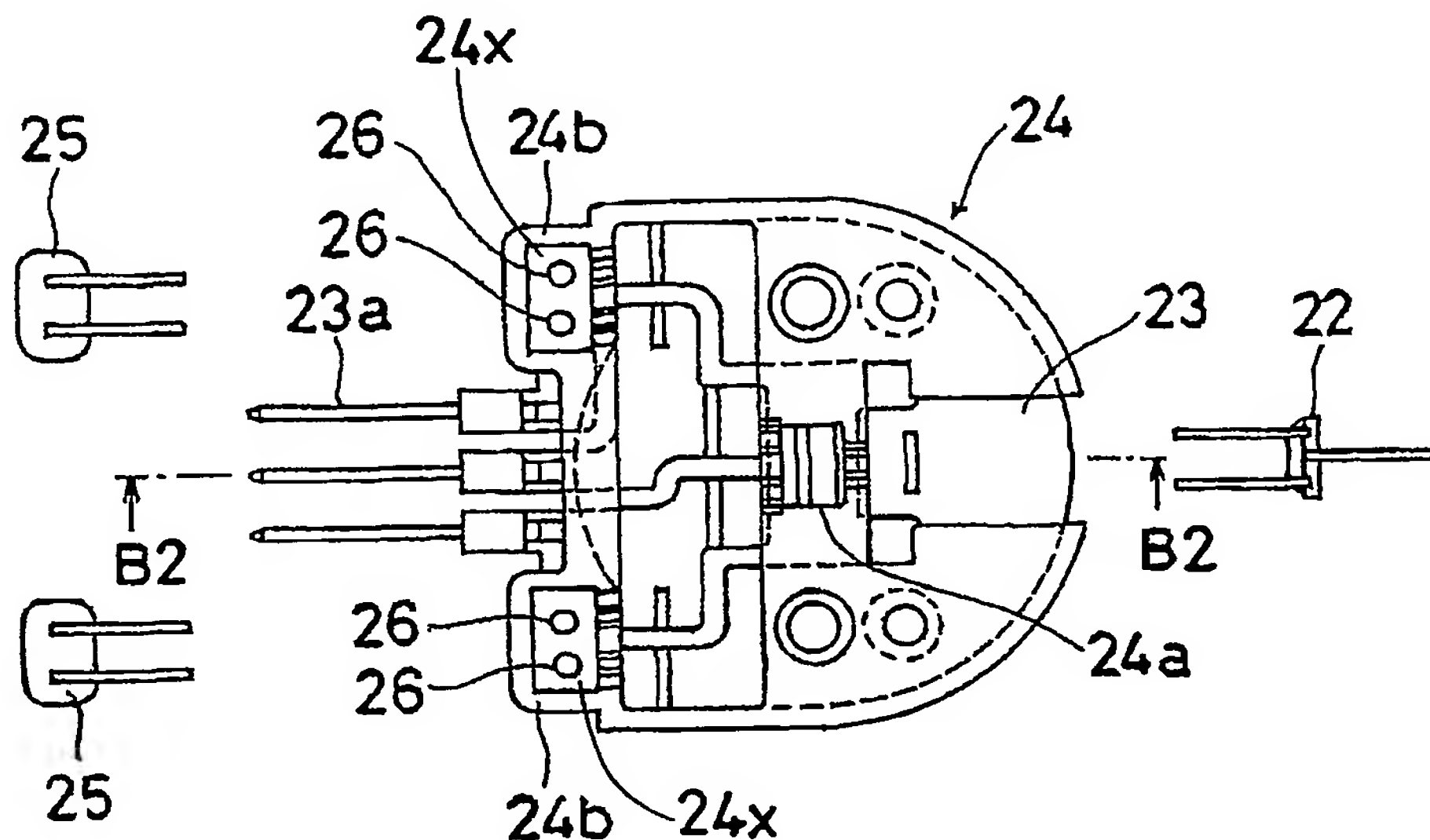
(74) 代理人: 大川 宏 (OHKAWA, Hiroshi); 〒4500002 愛知
県名古屋市中村区名駅 3 丁目 2 番 5 号 Aichi (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

[続葉有]

(54) Title: STRUCTURE FOR HOLDING ELECTRONIC COMPONENT

(54) 発明の名称: 電子部品の保持構造



(57) Abstract: A structure for holding an electronic component has a first resin mold having a positioning shape section for an electronic component and a second resin mold insert-molded so as to surround the first resin mold and the electronic component positioned in the first resin mold. A through-hole through which an insert resin material for the second resin mold is formed in the positioning shape section of the first resin mold. With the structure above, electronic component positioning accuracy is increased by the positioning shape section for receiving an electronic component, and deformation and cracks, caused by insert molding, in the positioning shape section for the electronic component are prevented from occurring.

(57) 要約: 電子部品の保持構造は、電子部品の位置決め形状部を有する第 1 樹脂モールドと、第 1 樹脂モールド及び第 1 樹脂モールドに位置決めされた電子部品を包囲してインサート成形された第 2 樹脂モールドとを備えている。第 1 樹脂モールドの位置決

[続葉有]

WO 2005/052517 A1



DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

め形状部に第2樹脂モールドのインサート樹脂材料を通過する貫通孔が形成されている。電子部品の保持構造において、電子部品を収容する位置決め形状部により電子部品の位置決め精度の向上と、インサート成形による電子部品の位置決め形状部の変形やクラック発生を未然に防止する。